公司代码:688125　　公司简称:安达智能

广东安达智能装备股份有限公司

2025 年度报告摘要

第一节重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的风险,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分的内容,请投资者注意投资风险。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是√否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据《上市公司监管指引第3号–上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负,未实现盈利,公司2025年度拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本及其他形式的利润分配。以上利润分配预案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

母公司存在未弥补亏损

□适用√不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用√不适用

第二节公司基本情况

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用□不适用

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	安达智能	688125	不适用

1.2公司存托凭证简况

□适用√不适用

1.3联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨明辉	叶慧
联系地址	广东省东莞市寮步镇向西东区路17号	广东省东莞市寮步镇向西东区路17号
电话	0755-86544020	0755-86544020
传真	0769-83373692	0769-83373692
电子信箱	anda-ir@anda-dg.com	anda-ir@anda-dg.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

1、主要业务

公司主要从事流体控制设备、等离子设备、固化及组装设备、ADA智能平台、半导体装备等智能制造设备及系统平台的研发、生产和销售,产品可广泛运用于消费电子、汽车电子、AI服务器、新能源、半导体、智能家居、医疗等多领域电子产品的智能生产制造,致力为客户提供工厂智能制造整体解决方案。

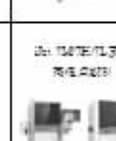
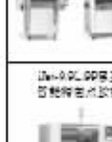
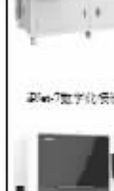
历经多年发展和技术积累,公司已形成核心零部件研发、运动算法和整体机结构设计的一体化技术平台,依托一体化技术平台,公司的智能制造装备已在技术水平、生产效率和交付速度等方面具备较强的竞争优势,已与全球科技行业头部客户及产业链EMS客户建立了长期、稳定、深度的合作关系,帮助其在点胶、涂覆、等离子清洗和组装等多个环节实现自动化、智能化和柔性化生产。

2、主要产品

公司产品主要包括点胶机、涂覆机、涂覆AOI检测设备、灌胶机、等离子清洗机、固化炉、智能组装设备、ADA智能平台、五轴联动数控机床、超快激光设备、仓储物流设备等多种智能制造装备和点胶阀体、驱控、电机等多种核心零部件,是电子信息制造业实现自动化、智能化和高效化生产的关键核心装备,目前已形成了以高端流体控制设备为核心、覆盖多道工序的多元化产品布局。

(1)流体控制设备

流体控制设备主要包括点胶机、涂覆机、灌胶机和喷墨机等。流体控制设备可广泛应用于消费电子、汽车电子、新能源、智能家居和半导体等领域产品的SMT电子装联段、FATP后段组装的底部填充、围坝、引脚封装、堆栈封装POP、补强、三防涂覆等工艺,以实现电子产品的贴装和部件组装。

产品类别	产品系列	典型产品图示	产品特征
点胶机	AD系列(桌面)		1.特性:高平稳度一体式机身,采用伺服SMT胶阀和胶缸,点胶模组,3D扫边,IC点胶机械,封装点胶等工艺。 2.产品特点:XY轴采用直线电机,高刚性设计,集成CCD视觉系统,可实现取料、点胶检测、检测复检、检测修复、自动清除、自动更换不同规格胶阀及点胶针头、自动清除胶阀残胶及点胶针、自动清洁等功能。
	AD系列(在线)		1.特性:结构紧凑,可实现单、双轨传输,Mini尺寸设计,适用于小尺寸产品的点胶、封装检测。 2.产品特点:采用直线电机驱动,高速高精度,支持单、双轨传输,适用于PCB板、MiniLED板点胶,可根据客户需求实现点胶、封装、检测等功能,最大可实现300mm×60mm,可实现四个点胶阀同时工作。
	iAn-V系列(高精度点胶机)		1.用途:适用于LED、封装模组、八寸、小尺寸产品的点胶应用,满足精细化要求,实现点胶、检测、补强、FPC点胶等(适用板:晶片、MTO等)点胶。 2.产品特点:采用双轨点胶设计,可实现Mini模组的同时点胶,点胶模组采用直线电机驱动,可实现高精度点胶,点胶阀采用SMT胶阀,点胶检测采用3D检测,可实现点胶检测、复检、修复、自动清除胶阀残胶及点胶针头、自动清洁等功能。
	iAn-S30/S11系列(高精度在线点胶机)		1.用途:适用于3C、半导体封装等精密打点点胶应用工艺(包括不规则轨迹、点胶线段、点胶圆弧、IGBT点胶、点胶等)。 2.产品特点:压电式喷射阀点胶,可实现高频率点胶,点胶频率可达1000Hz,最小点胶量可达0.1mg,可实现点胶线宽0.5mm,点胶线宽公差±0.05mm,点胶线宽一致性≤±5%,点胶位置公差±0.05mm,可实现点胶检测、复检、修复、自动清除胶阀残胶及点胶针头、自动清洁等功能。
	高线宽点胶机		1.用途:适用于SMT、封装、检测、点胶、点胶检测、复检、修复、自动清除胶阀残胶及点胶针头、自动清洁等工艺。 2.产品特点:采用直线电机驱动,高刚性设计,集成CCD视觉系统,可实现点胶检测、复检、修复、自动清除胶阀残胶及点胶针头、自动清洁等功能。
	ADC 3D二维高线点胶机		1.用途:点胶封装、点胶模组、多部位点胶、检测点胶、CCD、固化等模式、点胶、FPC点胶等工艺。 2.产品特点:(1)采用直线电机驱动,高刚性设计,集成CCD、固化等模式、点胶、FPC点胶等工艺。(2)采用直线电机驱动,高刚性设计,集成CCD、固化等模式、点胶、FPC点胶等工艺。(3)高速高精度点胶,点胶精度±0.05mm,点胶线宽公差±0.05mm,点胶线宽一致性≤±5%,点胶位置公差±0.05mm,可实现点胶检测、复检、修复、自动清除胶阀残胶及点胶针头、自动清洁等功能。
涂覆机	iCoat系列		iCoat-3精密涂覆机 1.用途:适用于多种产品涂覆应用,可实现多种胶水涂覆,满足精细工艺多样化需求及高效率涂覆工艺。 2.产品特点:可根据工艺需求选择多种不同规格胶阀设备,可实现多种涂覆、检测多种应用,满足多种精细产品需求。
			iCoat-5精密涂覆机 1.用途:适用于对电子元器件和引脚等特殊结构区域,采用多轴联动涂覆工艺,提升对复杂结构精细涂覆。 2.产品特点:可根据客户需求选择多种胶阀设备,可实现多种涂覆、检测多种应用,满足多种精细产品需求。
			iCoat-6精密涂覆机 1.用途:适用于高线宽涂覆应用,可实现高效率涂覆工艺。 2.产品特点:采用直线电机驱动,高刚性设计,集成CCD视觉系统,可实现检测、复检、修复、自动清除胶阀残胶及点胶针头、自动清洁等功能。
灌胶机	iVac-900L/PP系列(真空灌胶机)		1.用途:适用于LED、封装模组、八寸、小尺寸产品的点胶应用,满足精细化要求,实现点胶、检测、补强、FPC点胶等(适用板:晶片、MTO等)点胶。 2.产品特点:采用双轨点胶设计,可实现Mini模组的同时点胶,点胶模组采用直线电机驱动,可实现高精度点胶,点胶阀采用SMT胶阀,点胶检测采用3D检测,可实现点胶检测、复检、修复、自动清除胶阀残胶及点胶针头、自动清洁等功能。
	iVac-S30/S11系列(真空灌胶机)		1.用途:适用于3C、半导体封装等精密打点点胶应用工艺(包括不规则轨迹、点胶线段、点胶圆弧、IGBT点胶、点胶等)。 2.产品特点:压电式喷射阀点胶,可实现高频率点胶,点胶频率可达1000Hz,最小点胶量可达0.1mg,可实现点胶线宽0.5mm,点胶线宽公差±0.05mm,点胶线宽一致性≤±5%,点胶位置公差±0.05mm,可实现点胶检测、复检、修复、自动清除胶阀残胶及点胶针头、自动清洁等功能。
喷墨机	TSV-200D/300系列(点胶点胶机)		1.用途:适用封装、点胶模组、多部位点胶、检测点胶、CCD、固化等模式、点胶、FPC点胶等工艺。 2.产品特点:设备为高线宽点胶设备,适用于点胶应用,满足精细化要求,实现点胶检测、复检、修复、自动清除胶阀残胶及点胶针头、自动清洁等功能。
	ADC系列(在线)		1.用途:适用封装、点胶模组、多部位点胶、检测点胶、CCD、固化等模式、点胶、FPC点胶等工艺。 2.产品特点:(1)采用直线电机驱动,高刚性设计;(2)采用直线电机驱动,高刚性设计,可实现检测、复检、修复、自动清除胶阀残胶及点胶针头、自动清洁等功能;(3)高速高精度点胶,点胶精度±0.05mm,点胶线宽公差±0.05mm,点胶线宽一致性≤±5%,点胶位置公差±0.05mm,可实现点胶检测、复检、修复、自动清除胶阀残胶及点胶针头、自动清洁等功能;(4)可根据客户需求选择多种不同规格胶阀设备,可实现多种涂覆、检测多种应用,满足多种精细产品需求。
灌胶机	iCoat系列		iCoan-3精密灌胶机 1.用途:适用于多种产品灌胶应用,可实现多种胶水灌胶,满足精细工艺多样化需求及高效率灌胶工艺。 2.产品特点:可根据工艺需求选择多种不同规格胶阀设备,可实现多种灌胶、检测多种应用,满足多种精细产品需求。
			iCoan-5精密灌胶机 1.用途:适用于对电子元器件和引脚等特殊结构区域,采用多轴联动灌胶工艺,提升对复杂结构精细灌胶。 2.产品特点:可根据客户需求选择多种不同规格胶阀设备,可实现多种灌胶、检测多种应用,满足多种精细产品需求。
			iCoan-6精密灌胶机 1.用途:适用封装、点胶模组、多部位点胶、检测点胶、CCD、固化等模式、点胶、FPC点胶等工艺。 2.产品特点:(1)采用直线电机驱动,高刚性设计;(2)采用直线电机驱动,高刚性设计,可实现检测、复检、修复、自动清除胶阀残胶及点胶针头、自动清洁等功能;(3)高速高精度点胶,点胶精度±0.05mm,点胶线宽公差±0.05mm,点胶线宽一致性≤±5%,点胶位置公差±0.05mm,可实现点胶检测、复检、修复、自动清除胶阀残胶及点胶针头、自动清洁等功能。
等离子设备	高线宽等离子清洗机		1.用途:适用于SMT、封装、检测、点胶、点胶检测、复检、修复、自动清除胶阀残胶及点胶针头、自动清洁等工艺。 2.产品特点:采用直线电机驱动,高刚性设计,集成CCD视觉系统,可实现点胶检测、复检、修复、自动清除胶阀残胶及点胶针头、自动清洁等功能。

(2)等离子设备

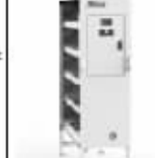
等离子设备主要有真空等离子清洗机和常压等离子清洗机,用于清洗FPC、PCB、半导体引线支架、玻璃和各种手机零部件等表面有机物,以提高产品表面附着力,从而提升产品可靠度。

产品系列	典型产品图示	产品特征
VP系列	VP-10L在线式高线等离子清洗机	1.用途:清洗FPC、PCB、玻璃和手机零部件等表面有机物,增强表面附着力。 2.产品特点:采用双轨传输设计,单轨传输时间≤11秒,适用于小尺寸产品,可实现高效清洗,适应高线宽工艺,并可满足客户以单人操作模式实现全自动作业。
	VP-A01_S01系列(全自动高线宽等离子清洗机)	1.用途:清洗FPC、PCB、玻璃和手机零部件等表面有机物,增强表面附着力。 2.产品特点:具有独立的真空腔体,单腔单次可处理4片,可实现高效清洗,适应大批量生产需求,单腔清洗时间≤40秒,可实现高效清洗,适应高线宽工艺,并可满足客户以单人操作模式实现全自动作业。
	VP-10R高线宽卷带等离子清洗机	1.用途:适用于卷带产品的清洗,可实现卷带产品的高效清洗,适应高线宽工艺,并可满足客户以单人操作模式实现全自动作业。 2.产品特点:采用双轨传输设计,单轨传输时间≤40秒,可实现高效清洗,适应高线宽工艺,并可满足客户以单人操作模式实现全自动作业。
AP系列	AP-U系列卷带等离子清洗机	1.用途:适用于卷带产品的清洗,可实现卷带产品的高效清洗,适应高线宽工艺,并可满足客户以单人操作模式实现全自动作业。 2.产品特点:采用双轨传输设计,单轨传输时间≤40秒,可实现高效清洗,适应高线宽工艺,并可满足客户以单人操作模式实现全自动作业。

(3)固化、智能组装设备及其他设备

固化设备包括红外固化炉、紫外固化炉和热风固化炉,主要用于产品完成点胶或涂覆、灌胶或打印等工序后的固化或烘干。智能组装设备主要用于零部件或产品贴装、插装、锁付等工序,包括上料机、下料机和传输设备等其他设备。

ADA智能平台是在通用机架的基础上搭载主机模组形成一个通用平台,再在通用平台基础上搭载不同的工艺模块、供料模块、输送和校准模块以快速形成一台智能平台设备,实现给什么工具和物料就能完成相应的工序工作,如点胶、涂覆、组装、等离子清洗、锁付、视觉检测等。ADA智能平台的“智能”体现在设备具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应的特点,能有效解决制造业设备不通用、故障排除时间长、操作技术门槛高、换线转产不灵活的行业四大痛点问题。

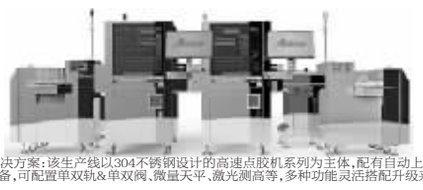
产品类别	产品系列	典型产品图示	产品特征
固化设备	红外固化		1.用途:用于利用红外线进行固化。 2.产品特点:在固化腔设计、隔离加热区域、温控等方面具有优势,能有效提高固化效率,减少能耗,适用于对温度敏感的工艺。
	紫外固化		1.用途:UV光固化,实现快速固化。 2.产品特点:采用高强度UV光源,能实现快速固化,适用于对固化时间要求较高的工艺。
	热风固化		1.用途:用于需要热风循环固化的工艺,适用于胶水、油墨等材料的固化。 2.产品特点:具有风速可调、温度均匀性高、节能设计等特点,适用于对固化质量要求较高的工艺。
灌胶设备	AD系列智能灌胶机		1.用途:用于SMT、封装、检测、点胶、点胶检测、复检、修复、自动清除胶阀残胶及点胶针头、自动清洁等工艺。 2.产品特点:(1)采用直线电机驱动,高刚性设计;(2)采用直线电机驱动,高刚性设计,可实现检测、复检、修复、自动清除胶阀残胶及点胶针头、自动清洁等功能;(3)高速高精度点胶,点胶精度±0.05mm,点胶线宽公差±0.05mm,点胶线宽一致性≤±5%,点胶位置公差±0.05mm,可实现点胶检测、复检、修复、自动清除胶阀残胶及点胶针头、自动清洁等功能。
	高速点胶设备		1.用途:用于SMT、封装、检测、点胶、点胶检测、复检、修复、自动清除胶阀残胶及点胶针头、自动清洁等工艺。 2.产品特点:采用直线电机驱动,高刚性设计,集成CCD视觉系统,可实现点胶检测、复检、修复、自动清除胶阀残胶及点胶针头、自动清洁等功能。
	五轴联动数控机床		1.用途:用于SMT、封装、检测、点胶、点胶检测、复检、修复、自动清除胶阀残胶及点胶针头、自动清洁等工艺。 2.产品特点:采用五轴联动数控机床,可实现点胶检测、复检、修复、自动清除胶阀残胶及点胶针头、自动清洁等功能。
等离子设备	真空等离子清洗机		1.用途:用于SMT、封装、检测、点胶、点胶检测、复检、修复、自动清除胶阀残胶及点胶针头、自动清洁等工艺。 2.产品特点:采用真空等离子清洗,可实现点胶检测、复检、修复、自动清除胶阀残胶及点胶针头、自动清洁等功能。
	常压等离子清洗机		1.用途:用于SMT、封装、检测、点胶、点胶检测、复检、修复、自动清除胶阀残胶及点胶针头、自动清洁等工艺。 2.产品特点:采用常压等离子清洗,可实现点胶检测、复检、修复、自动清除胶阀残胶及点胶针头、自动清洁等功能。
智能组装设备	五轴联动数控机床		1.用途:用于SMT、封装、检测、点胶、点胶检测、复检、修复、自动清除胶阀残胶及点胶针头、自动清洁等工艺。 2.产品特点:采用五轴联动数控机床,可实现点胶检测、复检、修复、自动清除胶阀残胶及点胶针头、自动清洁等功能。
	自动锁螺丝机		1.用途:用于SMT、封装、检测、点胶、点胶检测、复检、修复、自动清除胶阀残胶及点胶针头、自动清洁等工艺。 2.产品特点:采用自动锁螺丝机,可实现点胶检测、复检、修复、自动清除胶阀残胶及点胶针头、自动清洁等功能。
	自动贴标机		1.用途:用于SMT、封装、检测、点胶、点胶检测、复检、修复、自动清除胶阀残胶及点胶针头、自动清洁等工艺。 2.产品特点:采用自动贴标机,可实现点胶检测、复检、修复、自动清除胶阀残胶及点胶针头、自动清洁等功能。
	自动锁螺丝机		1.用途:用于SMT、封装、检测、点胶、点胶检测、复检、修复、自动清除胶阀残胶及点胶针头、自动清洁等工艺。 2.产品特点:采用自动锁螺丝机,可实现点胶检测、复检、修复、自动清除胶阀残胶及点胶针头、自动清洁等功能。
视觉检测设备	在线视觉检测设备		1.用途:用于SMT、封装、检测、点胶、点胶检测、复检、修复、自动清除胶阀残胶及点胶针头、自动清洁等工艺。 2.产品特点:采用在线视觉检测设备,可实现点胶检测、复检、修复、自动清除胶阀残胶及点胶针头、自动清洁等功能。
	在线视觉检测设备		1.用途:用于SMT、封装、检测、点胶、点胶检测、复检、修复、自动清除胶阀残胶及点胶针头、自动清洁等工艺。 2.产品特点:采用在线视觉检测设备,可实现点胶检测、复检、修复、自动清除胶阀残胶及点胶针头、自动清洁等功能。
	AD-PTL序列全自动视觉检测机		1.用途:用于SMT、封装、检测、点胶、点胶检测、复检、修复、自动清除胶阀残胶及点胶针头、自动清洁等工艺。 2.产品特点:采用全自动视觉检测机,可实现点胶检测、复检、修复、自动清除胶阀残胶及点胶针头、自动清洁等功能。
	AD-L300在线式自动视觉检测机(AOI)		1.用途:用于SMT、封装、检测、点胶、点胶检测、复检、修复、自动清除胶阀残胶及点胶针头、自动清洁等工艺。 2.产品特点:采用在线式自动视觉检测机,可实现点胶检测、复检、修复、自动清除胶阀残胶及点胶针头、自动清洁等功能。
	AD-DL300高速机械手检测机器人		1.用途:用于SMT、封装、检测、点胶、点胶检测、复检、修复、自动清除胶阀残胶及点胶针头、自动清洁等工艺。 2.产品特点:采用高速机械手检测机器人,可实现点胶检测、复检、修复、自动清除胶阀残胶及点胶针头、自动清洁等功能。
	AD-TL100/HD全自动视觉检测机		1.用途:用于SMT、封装、检测、点胶、点胶检测、复检、修复、自动清除胶阀残胶及点胶针头、自动清洁等工艺。 2.产品特点:采用全自动视觉检测机,可实现点胶检测、复检、修复、自动清除胶阀残胶及点胶针头、自动清洁等功能。
自动锁螺丝设备	在线式锁螺丝机		1.用途:用于SMT、封装、检测、点胶、点胶检测、复检、修复、自动清除胶阀残胶及点胶针头、自动清洁等工艺。 2.产品特点:采用在线式锁螺丝机,可实现点胶检测、复检、修复、自动清除胶阀残胶及点胶针头、自动清洁等功能。
自动贴标设备	平移式贴标机		1.用途:用于SMT、封装、检测、点胶、点胶检测、复检、修复、自动清除胶阀残胶及点胶针头、自动清洁等工艺。 2.产品特点:采用平移式贴标机,可实现点胶检测、复检、修复、自动清除胶阀残胶及点胶针头、自动清洁等功能。

(4)配件及技术服务

公司销售的配件以阀体为主,包括点胶阀、涂覆阀、雾化阀、薄膜阀等,用于消费电子、汽车电子、LED、新能源等多领域的表面贴装胶、导电银浆、IC封装胶、底部填充胶、涂助焊剂或活化剂等工序环节。技术服务业务是公司为保障客户生产线的稳定、安全、高效运行而提供的运营维护服务,具体内容包括智能制造装备的操作培训、定期检查、维护保养、故障分析等,贯穿了客户智能化生产的全生命周期,有效提升客户黏性。

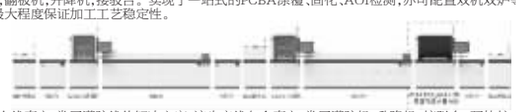
(5)智能生产解决方案

公司除了销售单一整机设备外,还致力于为客户提供覆盖PCBA加工、终端组装等多环节的智能生产整线解决方案,可广泛应用于消费电子、汽车电子、新能源、半导体、智能家居及医疗等多行业领域的电子产品智能生产制造。

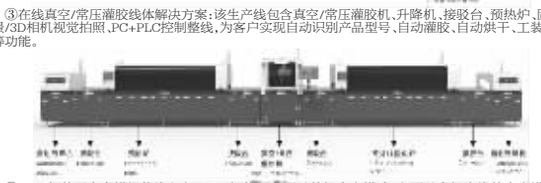


①点胶线体解决方案:该生产线以304不锈钢设计的高速点胶机系列为主体,配有自动上下料机、接驳台、UV检测台等设备,可配置单双轨&单双阀、微量天平、激光测高等,多种功能灵活搭配升级来实现不同的点胶工艺。

②PCBA板涂覆解决方案:该生产线以iCoat系列涂覆机为主体,还配置了IR固化炉,双面飞拍AOI涂覆检测机,翻板机,升降机,接驳台。实现了一站式的PCBA涂覆、固化、AOI检测,亦可配置双机双炉等定制化方案,最大程度保证加工工艺稳定性。



③在线真空/常压灌胶线体解决方案:该生产线包含真空/常压灌胶机、升降机、接驳台、预热炉、固化炉、全景/3D相机视觉拍照、PC+PLC控制整线,为客户实现自动识别产品型号、自动灌胶、自动烘干、工装自动回流等功能。



④ADA智能平台多模组整线方案:ADA智能平台可以单机生产模式,亦可以多机连线的生产模式。根据产品的工艺流程、产能需求与排线平衡,公司可以为客户自定义布局模组,采用多单元和各种工艺模块的组合实现量产目的,换线只需更换模块即可,无需移动设备。ADA智能平台不同工作站选配不同工艺模块,或与人工位或与其他专用设备混搭结合使用,能实现产线的无限扩展,为快速搭建大型生产线提供一站式智能制造服务。通过搭载LMES系统实现离线排产、离线编程、离线生产等,使其有效解决制造业设备通用性低、故障排除时间长、操作技术门槛高、换线转产不灵活的四大行业痛点。

2.2主要经营模式

1、盈利模式

公司已建立覆盖智能制造装备研发、生产和销售为一体的完整业务模式,基于产品的前期研发投入、生产成本等因素制定产品价格,并通过向客户销售智能制造装备、提供配件及技术服务实现盈利。

2、采购模式

公司主要根据生产计划、研发需求以及销售订单相关的产品BOM清单,按需下达采购订单。此外,公司亦会根据与客户沟通的预测订单安排批量生产,并依此提前采购一部分通用物料,以满足生产排产的领料需求。公司直接采购的物料以标准化零配件为主,属于原材料采购,直接面向供应商进行采购。另外,公司还会委托部分供应商进行部分五金件、机加件、电气件的简单加工,即外协加工模式,公司向其支付加工费。

3、生产模式

公司以自主生产为主,对少部分附加值较低的钣金件、机加件和电气件的简单加工以委托加工方式进行。在生产组织方面,公司主要为订单导向型,生产计划主要根据销售订单及客户告知的订单预测情况执行,公司会通过与客户深入沟通,充分了解主要客户当年度的预计产能需求,并根据客户生产计划着手开始进行材料采购、制定生产计划,确保生产计划均衡分配、按时完成、准时发货;在生产工艺方面,公司产品在标准设备的基础平台上,通过加载工艺模块、变更关键核心零部件或优化运动算法等方式,即可满足客户多样化的工艺需求。当客户有特殊的工艺需求时,公司亦会根据客户需求定制化生产。

4、研发模式

公司建立了研究院+研发中心+应用研发三层研发体系。其中,研究院定位为公司前沿技术策源地与核心部件研发中心,主攻驱控技术与工业软件两大方向,为公司全业务线提供底层技术支撑;研发中心定位为公司通用产品迭代与技术平台中心,聚焦公司通用型智能装备、软件平台的优化升级与标准化建设;应用研发定位为公司客户化解决方案与项目化交付中心,以客户需求与项目落地为核心导向,紧密对接下游行业应用场景与客户个性化需求。

5、销售模式

公司产品以直接销售为主。公司依托深厚的技术积累和快速交付等优势,实现了与全球电子信息产业头部客户及其EMS厂商的互赖互信,建立了长效而稳定的合作机制。公司直接与客户或其EMS厂商签订订单并直接发货,为其提供相关的智能制造装备及解决方案、零配件和技术服务。

2.3所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

1)公司所属行业及确定依据

公司主营业务为部品研发、流体控制设备、等离子设备、固化及智能组装设备等智能制造装备的研发、生产、销售及技术服务。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类(GB/T4754–2017)》,属于“C3569其他电子专用设备制造”;根据《战略性新兴产业分类(2018)》(国家统计局令第23号),属于“2.1智能制造装备产业–3569其他电子专用设备制造”;根据国家发展改革委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)》,公司产品属于“2.1.4智能加工装备”中的“智能基础制造装备”。

2)行业发展阶段

公司广义的行业分类属于智能装备制造业,生产的流体控制设备属于更为细分的电子专用设备制造行业。当前,我国智能装备制造行业正处于从单机自动化、产线数字化向智能化跃迁的关键期,上游核心零部件的技术突破与国产替代进程加速,软件、芯片的迭代升级,夯实了技术底座,有效降低了生产成本;下游新能源、汽车、3C等重点行业需求升级,带来了产业规模与应用水平的快速提升,国家统计局发布的《2025年国民经济和社会发展统计公报》显示,2025年我国新质生产力稳步成长,规模以上工业中装备制造业增加值同比增长9.2%。装备制造业作为新质生产力的核心承载领域,在“人工智能+制造”等政策的多重驱动下,行业逐渐呈现AI深度融合、自主可控强化、绿色低碳转型、规模化推广应用的发展特征,新型智能制造体系建设正加速推进。

尽管近年来在政策引导、技术创新与产业需求等多重因素驱动下,智能装备制造行业实现了稳步增长,但核心技术受制于人、产业链协同不足、专业人才缺口大以及企业智能化转型成本高、资源利用率低等短板仍待突破。

3)行业基本特点

①下游行业的高增长推动可持续发展

智能装备制造业的下游应用领域非常广泛,主要包括消费电子、AI服务器、新能源、汽车制造、半导体、医疗器械、家居等行业。当前消费电子行业整体呈现总量平稳、结构创新升级的发展态势,产品的快速迭代加快了生产设备更新、拉动智能装备制造业向高精度、高柔性、智能化方向升级。与此同时,我国AI服务器、新能源汽车、储能、半导体市场正处于快速发展阶段,市场需求旺盛,产业规模持续扩张,为智能制造装备市场注入强劲增长动能,行业用空间广阔、发展前景持续向好。

②关键核心零部件技术攻坚取得积极进展,自主化与高端化并行突破

核心零部件的结构设计与精密加工能力始终是支撑智能装备升级的关键基础。我国高端制造业因发展历程较短,在上游技术积累和产业链配套方面仍存短板,部分高端领域的关键材料、工艺及核心部件与国际先进水平存在代际差距,对外依存度较高。

在此背景下,2025年中央经济工作会议强调加强关键核心技术攻关。“十五五”规划纲要进一步聚焦战略必争领域和产业链供应链薄弱环节,提出采取超常规措施,全链条推动工业母机、高端仪器等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。工信部等六部门印发的《机械行业稳增长工作方案(2025—2026年)》明确实施产业基础再造工程,围绕重大技术装备和重点领域整机配套需求,发展高可靠、高强度、高品质基础零部件。国家标准委与工信部联合印发《工业母机高质量标准体系建设方案》,加快高端工业母机、高档数控系统、高性能功能部件、关键核心零部件等标准研制。基于上述政策引领,各地围绕制造业重点产业链持续深化自主创新,促进关键核心零部件技术积累,产业链和供应链的自主可控水平稳步提升,智能装备产业结构持续优化升级。

③高端制造领域设备国产化进程加速,智能制造向标准化与高质量升级

在全球制造业数字化、智能化转型的浪潮之下,智能装备作为新一代信息技术与先进制造技术深度融合的产物,成为各国争夺的核心赛道,也是我国国民经济的重要支柱产业。近年来,随着我国制造业转型升级步伐加快,高端装备制造自主创新成果显著,国产化进程明显提速,自主供给能力持续增强,工业机器人、数控机床、光伏锂电装备、半导体设备等关键领域国产化率逐年提升。目前在高端制造领域,国内已培育出具备全链条创新能力的智能装备企业集群,构建起产学研协同的技术创新体系,在核心算法、精密传动等关键领域实现自主突破,部分高端产品技术指标达到国际先进水平。尽管部分高端零部件、高端芯片、关键工艺环节等仍存在短板,但整体来看,国产高端设备市场份额持续扩大,为产业链自主可控与新质生产力发展提供坚实支撑。

当前行业核心任务正从规模扩张转向质量提升与标准化建设。2025年8月,工业和信息化部等八部门联合印发《机械工业数字化转型实施方案(2025—2030年)》(工信部联通装(2025)152号),明确构建“两步走”发展路径:到2027年实现智能制造能力成熟度二级及以上企业占比达50%、建成不少于200家卓越级智能工厂;到2030年,机械工业规上企业基本完成一轮数字化改造,重点企业的产业链供应链上下游实现数据互联、共享协同。该方案以智能制造为主攻方向,通过构建产学研协同创新体系,强化标准引领与技术融合,推动核心部件国产化率提升,并依托智能工厂梯度培育降低中小企业转型成本,进一步巩固国产替代成果,为行业从“单点突破”迈向“系统化生态重构”提供制度保障。

4)主要技术门槛

①技术壁垒

智能制造装备行业属于技术密集型、资金密集型、人才密集型行业,其发展融合了多学科技术体系且更新迭代快,是下游终端制造业突破工艺和产能限制的关键因素,因此企业需要在包括先进制造、光学成像、机械系统、电气控制、信息技术、人工智能等领域进行大量技术积累,持续开展技术攻关,储备行业应用经验,深度把握下游行业技术变革趋势,才能够在行业中立足并建立竞争优势。

②应用领域的行业经验壁垒

面对市场不断变化的终端产品,客户对智能制造装备的稳定性、精密性、安全性、可靠性以及供应商的售后服务和技术支持能力有较高的要求。智能制造装备企业需要根据客户行业特点、行业规范、贴合类型、功能需求、相关配套工程、客户预算等众多因素进行解决方案设计,以便更好地服务客户,因此下游客户更青